フィルム

熱プレス工程用離型フィルム

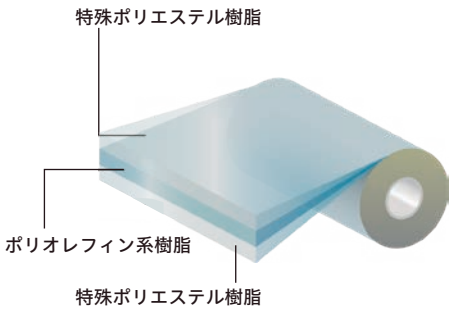
低アウトガス離型フィルム

保護　その他

製品HP／お問合せ

特　徴

製品構成

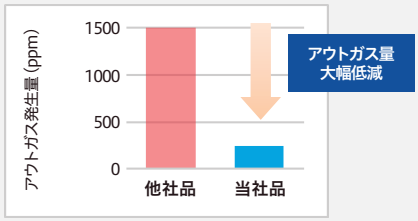


1. 熱プレス工程で発生するアウトガス成分が少ない離型フィルム
2. 高い機械的強度（引張強度、破断伸び、引裂強度など）
3. 高温の熱プレスにおいても優れた寸法安定性
4. 高段差の熱プレスでも追従・埋込みが可能

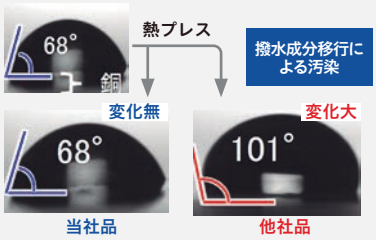
性　能

1. 低汚染性

アウトガス発生量評価
170℃×10分間のサンプル加熱による発成分の発生量（トルエン換算）

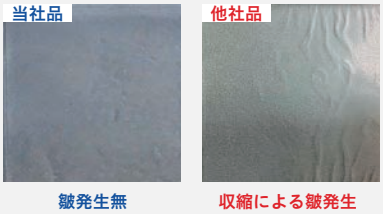


移行物評価
CCL（銅張積層板）との熱プレス後銅箔表面の水接触角の変化を測定

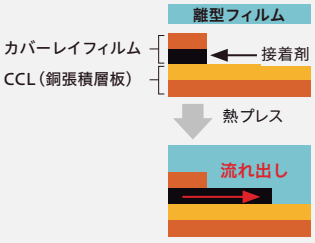


2. 寸法安定性

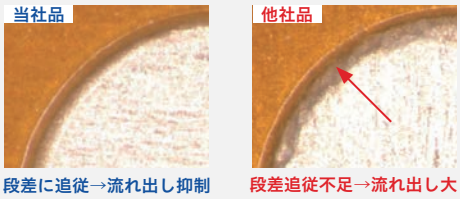
耐皺性評価
180℃×5分間加熱後外観確認



3. 高追従性

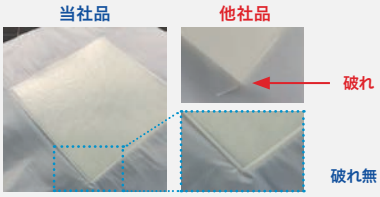


流れ出し評価　熱プレス時のカバーレイフィルム接着剤流れ出し量を測定



4. 機械強度

耐破れ評価
4mm厚基板と重ね合わせて 180℃で熱プレス



物　性

項目	平均厚み	融点	23℃引張強度（MD）	23℃破断伸度（MD）	80℃寸法変化率
物性値	100 - 190 μm	223℃	15 - 45 MPa	600 - 1000%	-0.6% - 0%

※上記の物性値は代表的な製品に基づく参考値であり、保証値ではありません。
※お客様のご要望に応じて物性値はカスタム可能です。

用途例

■基板製造時の熱プレス工程の表面保護
・フレキシブルプリント基板（FPC）、リジッドフレキ基板等製造時

■耐熱保護フィルム
・半導体モールド製造時　・次世代ディスプレイ製造時　・加飾用フィルム保護
・ACF圧着時　・CFRP製造時　・その他、熱プレス加工の保護用途

■フィルム基材
・耐熱柔軟基材用途

■その他
・カスタム対応可能

